



产品加工指南

覆铜板: S7136/S7136H

高频碳氢材料



本产品加工指南依托于 IPC-4103 标准，并在该标准的基础上，根据产品特征的实际情况进行整理，使之更利于生益 S7136/S7136H 产品的使用。

1. 储存条件

1.1 覆铜板

1.1.1 存放方式

- 以原包装形式放在平台上或适宜架上，避免重压，防止存放方式不妥而引起板材形变。

1.1.2 存放环境

- 板材宜存放在通风、干燥、室温的环境下，避免阳光直射、雨淋，避免腐蚀性气体侵蚀（存放环境直接影响板材品质）；
- 双面板在合适环境下存放两年，单面板在合适环境下存放一年，其内部性能可以满足 IPC4103 标准要求。

1.1.3 操作

- 需戴清洁手套小心操作板材。碰撞、滑动等会损伤铜箔；裸手操作会污染铜箔面，这些缺陷都可能会对板材的使用造成不良影响。

2. PCB 加工建议

2.1 开料

- 推荐选用锯床开料方式，其次使用剪床，注意辊刀开料可能会引发板边分层问题。

2.2 芯板烘烤

- 烘板不是必须的，可根据实际使用情况，选择对芯板进行烘烤；
- 如采用开料后烘烤，建议开料后先过一遍高压水洗后再烘烤，避免剪切过程中产生的树脂粉末引入到板面，引起蚀刻不良问题；
- 建议烘板条件：150°C/3 ~ 5h，注意板材不能与热源直接接触。
- 注意：烘烤后基材面颜色会加深，属正常现象。

2.3 内层棕化

- 内层芯板建议采用棕化处理，为避免流程的过多吸潮而影响板材的耐热性，可在棕化将芯板进行插架烘板（芯板叠放在一起烘板效果不佳），建议烘板条件：120°C/1 小时，烘板后 4 小时内进行层压。

2.4 叠料

- 叠料过程避免翻转的动作，以减少由此引起的翘曲变形问题。

2.5 层压

- 压合程序取决于使用的粘结片，根据粘结片的特性进行程序的选择。

2.6 钻孔

- 钻孔时最好使用新钻嘴，叠数建议 ≤ 2 块/叠，采用新钻头且钻嘴孔限建议适当降低，以保证良好的孔壁质



量。另外，使用密胺垫板，钻孔后需全部砂纸打磨并高压空气吹孔处理。如下钻孔参数供参考：

S7136H 的钻孔参数参考

钻头直径 mm	最大钻孔数	转速 KRPM	落速 IPM	回收速率 IPM
0.253	600	108	21	300
0.350	800	98	40.6	500
0.500	1000	95	50.4	800
0.600	800	90	47.6	800
0.750	1000	75	50.4	800
0.850	1000	68	52.5	800
0.950	1000	62	52.5	800
1.000	800	60	52.5	800
1.200	800	55	68	800
1.400	800	50	68	800
1.600	800	45	80	800
2.000	500	38	70	800
3.000	100	28	52	500
3.175	100	28	45	300
4.000	100	25	25	300
5.000	100	22	25	300
6.000	200	20	10	300

S7136H 与其他基材混压的 PCB 的钻孔参数

钻头直径 mm	最大钻孔数	转速 KRPM	落速 IPM	回收速率 IPM
0.253	600	108	24	300
0.350	800	98	46.4	500
0.500	1000	95	57.6	800
0.600	800	90	54.4	800
0.750	1000	75	57.6	800
0.850	1000	68	60	800
0.950	1000	62	60	800
1.000	800	60	60.5	800
1.001	800	60	56	800
1.200	800	55	68	800
1.600	800	45	80	800
2.000	500	38	70	800
3.000	100	28	52	500
3.175	100	28	45	300
4.000	100	25	25	300
5.000	100	22	25	300
6.000	200	20	10	300



- 在钻密集孔或孔径小于 0.6mm 的孔时，建议盖板铝片使用 LE 铝片。
- 加工高频混压多层板，钻孔建议 S7136H 面朝上，且使用高硬度的盖板；对于双面板和纯高频多层板，同时采用高硬度的盖板和垫板；
- 钻孔时建议考虑表面盖板和底面垫板的固定及缓冲效果，减少对钻头排屑及进刀和出刀所产生的孔边披锋和毛刺。
- 不建议钻孔后机械磨刷去毛刺，若一定要磨刷，使用对板面及铜面损伤影响最小的磨刷参数条件，以免降低铜皮的结合力。

2.7 钻孔后烘板

- 钻孔后不建议烘烤，烘烤可能导致密集孔边铜皮结合力下降。
- 如需烘烤，建议使用低温烘烤：125°C/2h，注意板材不能与热源直接接触。
- 注意：烘烤后基材面颜色会加深，属于正常现象。

2.8 去钻污

- 混压多层板建议使用一次 Plasma+一次水平化学除胶的方式进行除胶；
- 双面板建议使用一次水平化学除胶的方式进行除胶；
- 过高的溶胀 desmear 强度会增加铜箔鼓泡的风险，需注意控制；

2.9 沉铜电镀

- 通孔结构订单优先考虑采用水平沉铜线，建议根据板的应用结构设计来选择最佳沉铜方式。
- 垂直沉铜条件，需要考虑减少沉铜线设备的震动、气顶、挂板移动速度等会对板面产生应力及弯曲效果的影响，这是一个综合的效果，并且与 PCB 板的结构相对应。

2.10 树脂塞孔

- 对于 S7136H 多层板，电镀铜与外层基材开窗区域的结合力较低，在树脂塞孔后烘烤出现铜皮起泡的风险，建议在 S7136H 基材开窗位置增加防爆孔和防爆槽的设计。
- 对于 S7136H 多层板，如有树脂塞孔的结构，建议优先使用水平沉铜线进行加工。

2.11 阻焊油墨

- 阻焊油墨润湿时间较 FR-4 延长约一倍时间，以增加阻焊油墨附着力。
- 阻焊油墨后固化后应尽量避免做翻洗，以免降低铜箔附着力或者造成板面损伤。

2.12 返工

- 退锡、退阻焊油墨等操作，会降低基材与铜箔的结合力容易出现分层，也可能损伤板面，应尽量避免。

2.13 喷锡

- 适用于无铅喷锡工艺。

2.14 外形加工

- 建议采用铣床进行加工，不建议采用啤板方式进行加工。



2.15 包装

- 建议在包装前进行烘板，条件为 125-135°C/3-5h，以免潮气造成耐热性下降问题；
- 注意：烘烤后基材面颜色会加深，属正常现象。
- 包装材料建议采用铝箔真空包装。

3. 焊接

3.1 包装有效期

- 铝箔真空包装，有效期为 3 个月；
- 元件组装前最好 125°C/3~5h 烘烤后再使用。

3.1 回流焊接参数

- 适合于常规无铅回流焊接加工工艺。

在使用生益 S7136/S7136H 产品期间，如有任何疑问及建议，请随时联系生益，生益将给您提供快捷有效的技术服务。